

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二五年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2026年2月12日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二五年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二五年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.599 億美元，同比增長 22.4%，環比增長 3.9%。
- 毛利率 13.0%，同比上升 1.6 個百分點，環比下降 0.5 個百分點。
- 母公司擁有人應占利潤 1,750 萬美元，上年同期為虧損 2,520 萬美元，上季度為利潤 2,570 萬美元。

二零二六年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約在 6.5 億美元至 6.6 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 13%至 15%之間。

總裁致辭

公司董事會主席兼總裁白鵬博士對二零二五年第四季度及全年業績評論道：

“華虹半導體二零二五年第四季度銷售收入再創歷史新高，達 6.599 億美元，單季度毛利率為 13.0%，均符合指引預期。二零二五年全年，公司實現銷售收入 24.021 億美元，毛利率為 11.8%，同比均實現增長並符合管理層預期。在全球半導體市場受 AI 及其相關產品需求拉動、國內消費類需求回暖的背景下，公司產能維持高位運行，全年平均產能利用率為 106.1%，處於晶圓代工企業領先水準。”

白總繼續表示：“通過優化產品組合及降本增效，公司各特色工藝平臺均表現強勁，尤其是獨立式閃存和電源管理平臺，有力支撐了公司業績增長與利潤率上升。2025 年度，公司繼續推進擴大產能的戰略規劃，無錫第二條 12 英寸產線（FAB9）一階段產能建設超預期完成，上海 12 英寸製造基地（FAB5）收購事項有序推進。展望未來，公司將通過創新和快速迭代，持續高度聚焦於打造世界級特色工藝技術平臺，並深化與國內外戰略客戶的合作。我們有信心在全球半導體產業變局中把握增長機遇，力爭達到股東的長期期許。”

電話會議公告

日期 2026 年 2 月 12 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

04:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，董事會主席兼總裁
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/eicdo4wo> 作線上直播
(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下連結先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN
(個人身份識別碼)。

<https://register-conf.media-server.com/register/Blc6a59cc45c954742a912c5e8cd37e5a3>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共用您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	659,882	539,177	635,180	22.4 %	3.9 %
毛利	85,464	61,426	85,854	39.1 %	(0.5)%
毛利率	13.0 %	11.4 %	13.5 %	1.6	(0.5)
經營開支	(130,165)	(110,626)	(100,433)	17.7 %	29.6 %
其他收入/(損失)淨額	34,110	(40,468)	17,752	(184.3)%	92.1 %
稅前(損失)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173	(88.2)%	(433.8)%
所得稅開支	(8,069)	(6,596)	(10,363)	22.3 %	(22.1)%
期內損失	(18,660)	(96,264)	(7,190)	(80.6)%	159.5 %
淨利潤率	(2.8)%	(17.9)%	(1.1)%	15.1	(1.7)
以下各方應占：					
母公司擁有人	17,454	(25,199)	25,725	(169.3)%	(32.2)%
非控股權益	(36,114)	(71,065)	(32,915)	(49.2)%	9.7 %
持有人應占每股盈利					
基本	0.010	(0.015)	0.015	(166.7)%	(33.3)%
攤薄	0.010	(0.015)	0.015	(166.7)%	(33.3)%
付運晶圓(折合 8 吋千片)	1,448	1,213	1,400	19.4 %	3.4 %
產能利用率 ¹	103.8 %	103.2 %	109.5 %	0.6	(5.7)
淨資產收益率 ²	1.2 %	(1.6)%	1.6 %	2.8	(0.4)

二零二五年第四季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.599 億美元，同比增長 22.4%，環比增長 3.9%，主要得益於付運晶圓數量上升及平均銷售價格上漲。
- 毛利率 13.0%，同比上升 1.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及降本增效；環比下降 0.5 個百分點，主要由於人工開支上升。
- 經營開支 1.302 億美元，同比上升 17.7%，主要由於人工開支及折舊費用上升；環比上升 29.6%，主要由於人工開支上升。
- 其他收入淨額 3,410 萬美元，上年同期為其他損失淨額 4,050 萬美元，主要由於本期取得外幣匯兌收益而上年同期為外幣匯兌損失、財務費用下降及政府補貼上升；環比上升 92.1%，主要由於財務費用下降。
- 所得稅開支 810 萬美元，同比上升 22.3%，主要由於應課稅利潤增加。
- 期內損失 1,870 萬美元，同比減虧 80.6%，環比增加虧損 159.5%。
- 母公司擁有人應占利潤 1,750 萬美元，上年同期為虧損 2,520 萬美元，上季度為利潤 2,570 萬美元。
- 基本每股盈利 0.010 美元。
- 淨資產收益率（年化）1.2%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運資料除外)

	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (已審核)	同比
銷售收入	2,402,064	2,003,993	19.9 %
毛利	282,926	205,128	37.9 %
毛利率	11.8 %	10.2%	1.6
經營開支	(425,625)	(360,904)	17.9 %
其他收入淨額	54,170	21,984	146.4 %
稅前損失	(88,529)	(133,792)	(33.8)%
所得稅開支	(22,284)	(6,593)	238.0 %
年內損失	(110,813)	(140,385)	(21.1)%
淨利潤率	(4.6)%	(7.0)%	2.4
以下各方應占：			
母公司擁有人	54,881	58,108	(5.6)%
非控股權益	(165,694)	(198,493)	(16.5)%
持有人應占每股盈利			
基本	0.032	0.034	(5.9)%
攤薄	0.032	0.034	(5.9)%
付運晶圓(折合 8 吋千片)	5,384	4,545	18.5 %
產能利用率	106.1 %	99.5 %	6.6
淨資產收益率	0.9 %	0.9 %	-

二零二五年度

- 銷售收入 24.021 億美元，較上年度上漲 19.9%，主要得益于付運晶圓數量增加。
- 毛利率 11.8%，較上年度上升 1.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及降本增效，部分被折舊成本上升所抵消。
- 經營開支 4.256 億美元，較上年度上升 17.9%，主要由於研發開支上升。
- 其他收入淨額 5,420 萬美元，較上年度上升 146.4%，主要由於財務費用及外幣匯兌損失下降，政府補貼上升，部分被利息收入下降所抵消。
- 年內損失 1.108 億美元，較上年度減虧 21.1%。
- 母公司擁有人應占溢利 5,490 萬美元，較上年度小幅下降 5.6%。
- 基本每股盈利 0.032 美元。
- 淨資產收益率 0.9%。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
晶圓	634,431	96.1 %	512,677	95.1 %	121,754	23.7 %
其他	25,451	3.9 %	26,500	4.9 %	(1,049)	(4.0)%
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

■ 本季度 96.1%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圓	252,846	38.3 %	252,234	46.8 %	612	0.2 %
12 吋晶圓	407,036	61.7 %	286,943	53.2 %	120,093	41.9 %
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

■ 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.528 億美元及 4.070 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
中國 ³	539,345	81.8 %	450,782	83.7 %	88,563	19.6 %
北美 ⁴	72,825	11.0 %	48,120	8.9 %	24,705	51.3 %
亞洲其他 ⁵	28,378	4.3 %	26,017	4.8 %	2,361	9.1 %
歐洲	19,334	2.9 %	14,258	2.6 %	5,076	35.6 %
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 5.393 億美元，占銷售收入總額的 81.8%，同比增長 19.6%，主要得益於其他電源管理、MCU、閃存及 CIS 產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 7,280 萬美元，同比增長 51.3%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲其他地區的銷售收入 2,840 萬美元，同比增長 9.1%。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,930 萬美元，同比增長 35.6%，主要得益於 MCU 及 IGBT 產品的需求增加。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵包括中國台灣及日本。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	180,187	27.3 %	137,184	25.4 %	43,003	31.3 %
獨立式非易失性存儲器	56,610	8.6 %	46,056	8.5 %	10,554	22.9 %
功率器件	168,859	25.6 %	164,954	30.7 %	3,905	2.4 %
邏輯及射頻	80,424	12.2 %	67,491	12.5 %	12,933	19.2 %
模擬與電源管理	173,802	26.3 %	123,492	22.9 %	50,310	40.7 %
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.802 億美元，同比增長 31.3%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 5,660 萬美元，同比增長 22.9%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度功率器件銷售收入 1.689 億美元，同比增長 2.4%，主要得益於通用 MOSFET 產品需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 8,040 萬美元，同比增長 19.2%，主要得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.738 億美元，同比增長 40.7%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	186,687	28.3 %	129,033	23.9 %	57,654	44.7 %
90nm 及 95nm	163,929	24.8 %	106,414	19.7 %	57,515	54.0 %
0.11μm 及 0.13μm	69,767	10.6 %	70,233	13.0 %	(466)	(0.7)%
0.15μm 及 0.18μm	33,543	5.1 %	31,328	5.8 %	2,215	7.1 %
0.25μm	1,852	0.3 %	2,724	0.5 %	(872)	(32.0)%
0.35μm 及以上	204,104	30.9 %	199,445	37.1 %	4,659	2.3 %
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度 65nm 及以下工藝技術節點的銷售收入 1.867 億美元，同比增長 44.7%，主要得益於其他電源管理、閃存、MCU、CIS、邏輯及 RF 產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.639 億美元，同比增長 54.0%，主要得益於其他電源管理、MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工藝技術節點的銷售收入 6,980 萬美元，同比持平。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,350 萬美元，同比增長 7.1%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 190 萬美元，同比下降 32.0%，主要由於功率器件產品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.041 億美元，同比增長 2.3%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 % (未經審核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	同比 千美元	同比 %
消費電子	419,635	63.7 %	344,594	63.9 %	75,041	21.8 %
工業及汽車	146,724	22.2 %	124,037	23.0 %	22,687	18.3 %
通信	83,454	12.6 %	64,619	12.0 %	18,835	29.1 %
計算	10,069	1.5 %	5,927	1.1 %	4,142	69.9 %
銷售收入總額	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度消費電子作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 4.196 億美元，占銷售收入總額的 63.7%，同比增長 21.8%，主要得益於其他電源管理、MCU 及閃存產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.467 億美元，同比增長 18.3%，主要得益於其他電源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通信類產品銷售收入 8,350 萬美元，同比增長 29.1%，主要得益於 CIS、RF、智能卡芯片及模擬產品的需求增加。
- 本季度計算類產品銷售收入 1,010 萬美元，同比增長 69.9%，主要得益於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)
總產能(折合 8 吋矽片晶圓)	486	391	468
總體產能利用率	103.8%	103.2%	109.5%

- 本季度末月產能 486,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 103.8%。

付運晶圓

折合 8 吋千片晶圓	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,448	1,213	1,400	19.4 %	3.4 %

- 本季度付運晶圓 1,448,000 片，同比上升 19.4%，環比上升 3.4%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以仟美元計	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	3,791	2,617	2,332	44.9 %	62.6 %
管理費用 ⁷	126,374	108,009	98,101	17.0 %	28.8 %
經營開支	130,165	110,626	100,433	17.7 %	29.6 %

- 經營開支 1.302 億美元，同比上升 17.7%，主要由於人工開支及折舊費用上升；環比上升 29.6%，主要由於人工開支上升。

其他收入/(損失)淨額

以千美元計	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,932	3,481	3,625	13.0 %	8.5 %
利息收入	15,228	20,450	13,762	(25.5)%	10.7 %
匯兌收入/(損失)	7,014	(48,664)	3,746	(114.4)%	87.2 %
分占聯營公司溢利/(損失)	1,261	(433)	1,843	(391.2)%	(31.6)%
財務費用	(8,414)	(20,406)	(18,249)	(58.8)%	(53.9)%
政府補貼	16,280	4,705	12,741	246.0 %	27.8 %
其他	(1,191)	399	284	(398.5)%	(519.4)%
其他收入淨額	34,110	(40,468)	17,752	(184.3)%	92.1 %

- 其他收入淨額 3,410 萬美元，上年同期為其他損失淨額 4,050 萬美元，主要由於本期取得外幣匯兌收益而上年同期為外幣匯兌損失、財務費用下降及政府補貼上升；環比上升 92.1%，主要由於財務費用下降。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金使用分析

以千美元計	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	246,026	348,783	184,150	(29.5)%	33.6 %
投資活動所用現金流量淨額	(585,659)	(1,484,688)	(253,296)	(60.6)%	131.2 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	1,361,101	(50,929)	104,163	(2,772.5)%	1,206.7 %
外匯匯率變動影響淨額	34,759	(120,783)	22,816	(128.8)%	52.3 %
現金及現金等價物變動影響淨額	1,056,227	(1,307,617)	57,833	(180.8)%	1,726.3 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 2.460 億美元，同比下降 29.5%，主要由於向供應商支付貨款增加及收到的政府補貼下降，部分被客戶收款上升所抵消；環比上升 33.6%，主要由於收到的政府補貼上升。
- 投資活動所用現金流量淨額 5.857 億美元，其中包括固定資產投資支出 6.335 億美元，及其他權益工具投資 360 萬美元，部分被收到政府對設備的補助 3,660 萬美元，利息收入 1,360 萬美元及設備處置款 120 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 13.611 億美元，其中提取銀行借款 9.190 億美元，其他融資活動收到的現金 5.946 億美元，政府對財務費用的補助 1,210 萬美元及員工行權發行股份收到 470 萬美元，部分被償還銀行借款 1.361 億美元，支付利息 3,280 萬美元及支付租賃負債 40 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於十二月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)
資產總額	14,453,772	12,511,666
負債總額	5,289,541	3,502,618
所有者權益總額	9,164,231	9,009,048
資產負債率 ⁸	36.6%	28.0%

資本開支

以仟美元計	二零二五年 第四季度 (未經審核)	二零二五年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	74,527	19,305
華虹 12 吋	558,956	242,589
合計	633,483	261,894

- 本季度資本開支 6.335 億美元，其中 5.590 億美元用於華虹 12 吋，7,450 萬美元用於華虹 8 吋。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)
已竣工待售物業	215,511	223,302
存貨	544,368	526,840
貿易應收款項及應收票據	282,053	257,067
預付款項、其他應收款項及其他資產	561,328	494,222
應收關聯方款項	10,135	22,150
已凍結存款及定期存款	32,342	31,993
現金及現金等價物	4,960,960	3,904,733
流動資產總額	6,606,697	5,460,307
貿易應付款項	330,370	275,064
其他應付款項及暫估費用	1,008,586	704,754
計息銀行借款	403,748	340,686
租賃負債	3,229	3,598
政府補助	89,049	66,498
應付關聯方款項	6,225	7,832
應付所得稅	15,014	14,341
流動負債總額	1,856,221	1,412,773
淨營運資金	4,750,476	4,047,534
速動比率	3.1x	3.3x
流動比率	3.6x	3.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	37	37
存貨周轉天數	83	85

- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 2.571 億美元上升至本季度末的 2.821 億美元，主要由於銷售收入增加。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 4.942 億美元上升至本季度末的 5.613 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 2,220 萬美元下降至本季度末的 1,010 萬美元，主要由於本季度收到一家關聯方的租金款。
- 貿易應付款項由上季度末的 2.751 億美元上升至本季度末的 3.304 億美元，主要由於採購額增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 7.048 億美元上升至本季度末的 10.086 億美元，主要由於本季度應付資本開支上升。
- 計息銀行借款由上季度末的 3.407 億美元上升至本季度末的 4.037 億美元，主要由於長期銀行借款的一年內到期部分增加。
- 政府補助由上季度末的 6,650 萬美元上升至本季度末的 8,900 萬美元，主要由於本季度收到的政府補助增加。
- 淨營運資金 本季度末 47.505 億美元，流動比率 3.6。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 37 天。
- 存貨周轉天數 83 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)
銷售收入	659,882	539,177	635,180
銷售成本	(574,418)	(477,751)	(549,326)
毛利	85,464	61,426	85,854
其他收入及收益	44,107	29,155	34,361
投資物業的公平值損失	(2,844)	(39)	
銷售及分銷費用	(3,791)	(2,617)	(2,332)
管理費用	(126,374)	(108,009)	(98,101)
其他費用	-	(48,745)	(203)
財務費用	(8,414)	(20,406)	(18,249)
分占聯營公司溢利/(損失)	1,261	(433)	1,843
稅前(損失)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173
所得稅開支	(8,069)	(6,596)	(10,363)
期內損失	(18,660)	(96,264)	(7,190)
以下各方應占：			
母公司擁有人	17,454	(25,199)	25,725
非控股權益	(36,114)	(71,065)	(32,915)
持有人應占每股盈利			
基本	0.010	(0.015)	0.015
攤薄	0.010	(0.015)	0.015
用於計算持有人應占每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,736,132,077	1,718,222,223	1,731,461,953
用於計算持有人應占每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,736,269,454	1,724,086,667	1,733,014,365

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (已審核)
銷售收入	2,402,064	2,003,993
銷售成本	(2,119,138)	(1,798,865)
毛利	282,926	205,128
其他收入及收益	127,408	149,072
投資物業的公平值損失	(2,844)	(39)
銷售及分銷費用	(10,967)	(9,628)
管理費用	(414,658)	(351,276)
其他費用	(6,527)	(33,395)
財務費用	(68,214)	(97,113)
分占聯營公司溢利	4,347	3,459
稅前損失	(88,529)	(133,792)
所得稅開支	(22,284)	(6,593)
期內損失	(110,813)	(140,385)
以下各方應占：		
母公司擁有人	54,881	58,108
非控股權益	(165,694)	(198,493)
持有人應占每股盈利		
基本	0.032	0.034
攤薄	0.032	0.034
用於計算持有人應占每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,728,942,231	1,717,346,778
用於計算持有人應占每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,729,052,605	1,721,085,846

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	6,676,442	6,162,217	5,859,117
投資物業	219,772	220,223	164,153
使用權資產	64,482	65,141	77,761
無形資產	35,509	33,982	31,456
於聯營公司的投資	150,222	147,349	139,799
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	478,799	381,305	289,311
長期預付款項	221,849	41,142	21,008
非流動資產總額	7,847,075	7,051,359	6,582,605
流動資產			
已竣工待售物業	215,511	223,302	221,905
存貨	544,368	526,840	467,060
貿易應收款項及應收票據	282,053	257,067	270,461
預付款項、其他應收款項及其他資產	561,328	494,222	363,997
應收關聯方款項	10,135	22,150	18,324
已凍結存款及定期存款	32,342	31,993	31,624
現金及現金等價物	4,960,960	3,904,733	4,459,132
流動資產總額	6,606,697	5,460,307	5,832,503
流動負債			
貿易應付款項	330,370	275,064	298,372
其他應付款項及暫估費用	1,008,586	704,754	880,447
計息銀行借款	403,748	340,686	280,704
租賃負債	3,229	3,598	4,912
政府補助	89,049	66,498	57,563
應付關聯方款項	6,225	7,832	9,125
應付所得稅	15,014	14,341	31,115
流動負債總額	1,856,221	1,412,773	1,562,238
流動資產淨額	4,750,476	4,047,534	4,270,265
總資產減流動負債	12,597,551	11,098,893	10,852,870
非流動負債			
計息銀行借款	2,787,096	2,056,802	1,917,235
租賃負債	15,679	15,329	18,068
遞延稅項負債	35,964	17,714	10,948
其他非流動負債	594,581	-	-
非流動負債總額	3,433,320	2,089,845	1,946,251
淨資產	9,164,231	9,009,048	8,906,619
權益和負債權益			
股本	4,987,482	4,982,556	4,938,457
儲備	1,625,181	1,466,529	1,308,569
本公司擁有人應占權益	6,612,663	6,449,085	6,247,026
非控股權益	2,551,568	2,559,963	2,659,593
權益總額	9,164,231	9,009,048	8,906,619

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日	於十二月三十一日	於九月三十日
	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)	二零二五年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前(虧損)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173
折舊及攤銷	195,876	142,306	187,269
應占聯營公司(溢利)/損失	(1,261)	433	(1,843)
營運資金的變動及其它	62,002	295,712	(4,449)
經營活動所得現金流量淨額	246,026	348,783	184,150
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產專案	(633,483)	(1,546,384)	(261,894)
投資其他權益工具	(3,557)	-	(14,030)
收到政府對設備的補助	36,596	41,149	-
其他投資活動所得現金流量	14,785	20,547	22,628
投資活動所用現金流量淨額	(585,659)	(1,484,688)	(253,296)
融資活動現金流量：			
提取銀行貸款	919,025	84,551	99,923
發行股份所得收益	4,740	1,478	14,376
償還銀行貸款	(136,107)	(91,518)	(3,284)
已付利息	(32,834)	(50,498)	(4,971)
支付租賃負債	(428)	(401)	(1,881)
收到政府對財務費用的補助	12,124	5,459	-
其他融資活動收到的現金	594,581	-	-
融資活動所得/(用)現金流量淨額	1,361,101	(50,929)	104,163
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	1,021,468	(1,186,834)	35,017
期初現金及現金等價物	3,904,733	5,766,749	3,846,900
外匯匯率變動影響淨額	34,759	(120,783)	22,816
期末現金及現金等價物	4,960,960	4,459,132	3,904,733

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (已審核)
經營活動現金流量：		
稅前虧損	(88,529)	(133,792)
折舊及攤銷	734,928	555,832
應占聯營公司溢利	(4,347)	(3,459)
營運資金的變動及其它	7,940	40,914
經營活動所得現金流量淨額	649,992	459,495
投資活動現金流量：		
購買物業、廠房、設備及無形資產專案	(1,813,956)	(2,779,857)
購買其他權益工具	(17,587)	(17,618)
投資聯營企業	(2,794)	-
收到政府對設備的補助	49,186	41,149
其他投資活動所得現金流量	66,349	84,794
投資活動所用現金流量淨額	(1,718,802)	(2,671,532)
融資活動現金流量：		
發行股份所得收益	34,411	3,642
非控股權益資本注資	-	1,181,880
提取銀行貸款	2,018,029	289,285
償還銀行貸款	(1,076,224)	(183,524)
已付利息	(79,680)	(105,736)
向股東支付股息	-	(36,247)
收到政府對財務費用的補助	12,124	5,459
支付租賃負債	(4,025)	(4,634)
其他融資活動收到的現金	594,581	-
融資活動所得現金流量淨額	1,499,216	1,150,125
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	430,406	(1,061,912)
期初現金及現金等價物	4,459,132	5,585,181
外匯匯率變動影響淨額	71,422	(64,137)
期末現金及現金等價物	4,960,960	4,459,132

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

白鵬(董事長兼總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

承董事会命

華虹半導體有限公司

白鵬

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二六年二月十二日